



量産用原子拡散接合装置 BC7000シリーズ



キヤノンアネルバ株式会社
CANON ANELVA CORPORATION

【特長】

- ◆ スパッタリング極薄膜による強固な接合
- ◆ 様々な異種材料基板でも接合可能
- ◆ 用途に合わせて接合用スパッタリング材料の選択が可能

【BC7300外観】



【対応基板サイズ】

基板サイズ	BC7000	BC7300	Coming Soon!
φ 100 mm	✓		
φ 150 mm	✓		
φ 200 mm		✓	
φ 300 mm		✓	



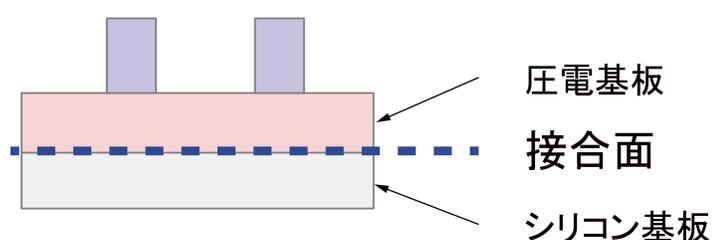
量産用原子拡散接合装置 BC7000シリーズ



キヤノンアネルバ株式会社
CANON ANELVA CORPORATION

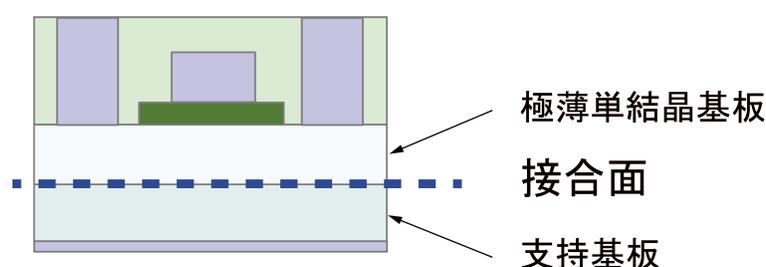
【想定される用途】

RF Filter



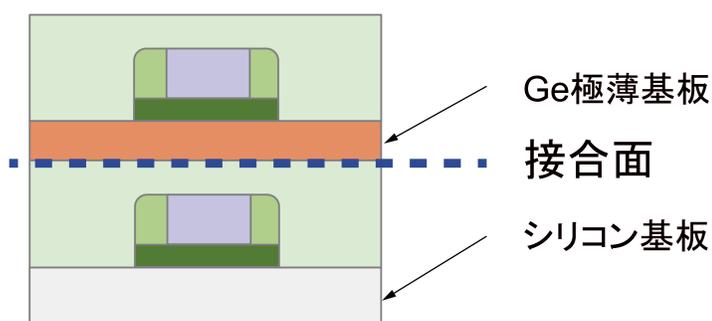
圧電基板とシリコン基板との接合

Power Device



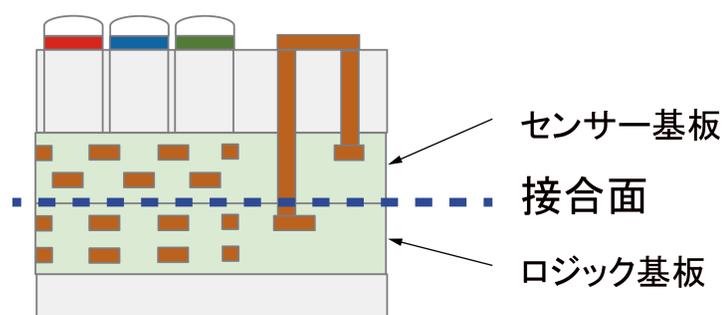
極薄単結晶基板と支持基板との接合

3D Sequential Process



Ge極薄基板とシリコン基板との接合

CMOS Image Sensor



センサー基板とロジック基板との接合

【用途別スパッタリング材料】

用途	スパッタリング材料		
	Ti	Si	酸化物・窒化物 (AlN等)
導電性の接合	✓	✓	
非金属での接合		✓	
接合部の絶縁性確保			✓
接合部の透明性確保			✓